# Submit 架构分析

## 一、 Submit 简介

2018年6月25日,TOP500组织发布了第51届全球超级计算机排行榜。在这个榜单中,来自于美国橡树岭国家实验室,受美国能源部资助的Summit 暂居超级计算机榜首。根据超算Top500排行的数据,Summit 超级计算机的峰值浮点性能为187.7PFlops,Linpack浮点性能为122.3PFlops,功耗为8805.5kW。在HPCG排行榜中,Summit 仍然暂居第一名的位置,HPCG性能为2925.75TFlops/s。

## 二、 Summit 的硬件配置

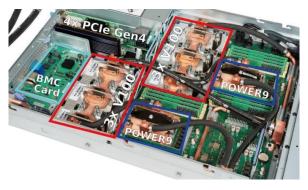
从硬件架构方面来看, Summit 依旧采用的是异构方式。

#### 1、概览

主 CPU 来自于 IBM Power 9,22 核心,主频为 3.07GHz,总计使用了 103752 颗,核心数量达到 2282544 个。GPU 方面搭配了 27648 块英伟达 Tesla V100 计算卡,总内存为 2736TB。操作系统为 RHEL 7.4。

从架构角度来看,Summit 并没有在超算的底层技术上予以彻底革新,而是通过不断使用先进制程、扩大计算规模来获得更高的性能。虽然扩大规模是提高超算效能的有效方式,但是为了将这样多的 CPU、GPU 和相关存储设备有效组合也是一件困难的事情。在这一点上,Summit 采用了多级结构。最基本的结构被称为计算节点,众多的计算节点组成了计算机架,多个计算机架再组成 Summit 超算本身。

### 2、计算节点

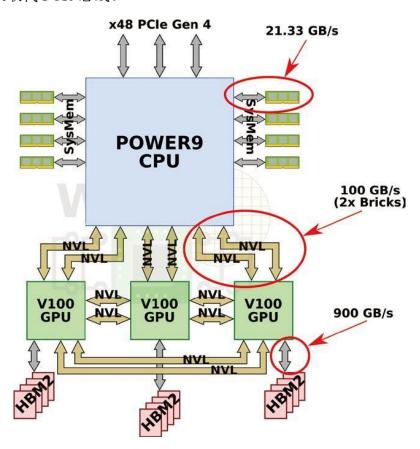


▲Summit 的一个计算节点,以及其内部设备。

①Summit 采用的计算节点型号为 Power System AC922, 后文我们将其简称为 AC922, 从内部布置来看,每个 AC922 内部有 2 个 CPU 插座,满足两颗 Power 9 处理器的需求。每颗处理器配备了 3 个 GPU 插槽,每个插槽使用一块 GV100 核心的计算卡。这样 2 颗处理器就可以搭配 6 颗 GPU。

②内存方面,每颗处理器设计了 8 通道内存,每个内存插槽可以使用 32GB DDR4 2666MHz 内存,这样总计可以给每个 CPU 可以带来 256GB、107.7GB/s 的内存容量和带宽。GPU 方面,它没有使用了传统的 PCIe 插槽,而是采用了 SXM2 外形设计,每颗 GPU 配备 16GB 的 HBM2 内存,对每个 CPU-GPU 组而言,总计有 48GB 的 HBM2 显存和 2.7TBps 的带宽。

③CPU 与 GPU 通信方面,在 Summit 上, CPU 和 GPU 之间的连接采用的是 NVLink 来取代 PCIe 总线。

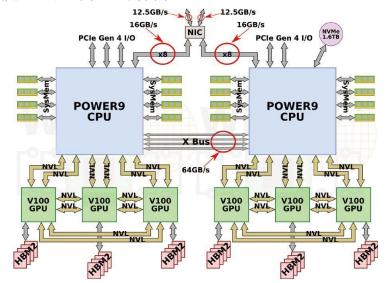


▲国外 WikiChip 机构制作的 Summit 内部 NVLink 2.0 连接示意图。

单颗 Power 9 处理器有 3 组共 6 个 NVLink 通道,每组 2 个通道。由于 Power 9 处理器的 NVLink 版本是 2.0,因此其单通道速度已经提升至 25GT/s,2 个通道可以在 CPU 和 GPU 之间实现双向 100GB/s 的带宽,此外,Power 9 还额外提供了 48 个 PCIe 4.0 通道。

GV100 GPU 也有 6 个 NVLink 2.0 通道,同样也分为 3 组,其中一组连接 CPU,另外 2 组连接其他两颗 GPU。和 CPU-GPU 之间的链接一样,GPU 与 GPU 之间的连接带宽也是 100GB/s。

④CPU 间通讯方面,每个 AC922 上拥有 2 个 CPU 插槽,因此 CPU 之间的通讯也很重要。Summit 的每个节点上,CPU 之间的通讯依靠的是 IBM 自家的 X 总线。X 总线是一个 4byte 的 16GT/s 链路,可以提供 64GB/s 的双向带宽,能够基本满足两颗处理器之间通讯的需求。



▲国外 WikiChip 机构制作的 Summit 内部 CPU 间通讯结构示意图

另外在 CPU 的对外通讯方面,每一个节点拥有 4 组向外的 PCIe 4.0 通道,包括两组 x16 (支持 CAPI),一组 x8 (支持 CAPI) 和一组 x4。其中 2 组 x16 通道分别来自于两颗 CPU,x8 通道可以从一颗 CPU 中配置,另一颗 CPU 可以配置 x4 通道。其他剩余的 PCIe 4.0 通道就用于各种 I/O 接口,包括 PEX、USB、BMC 和 1Gbps 网络等。

#### 3、机架和系统

机架是由计算节点组成的并行计算单元,Summit 的每个机架中安置了 18 个计算节点和 Mellanox IB EDR 交换器。每个节点都配备了双通道的 Mellanox InfiniBand ConnectX5 网卡,支持双向 100Gbps 带宽。节点的网卡直接通过插槽连接至 CPU,带宽为 12.5GBx2—实际上每个节点的网络都是由 2 颗 CPU 分出的 PCIe 4.0 x8 通道合并而成,PCI-E 4.0 x8 的带宽为 16GB/s,合并后的网卡可以为每颗 CPU 提供 12.5GB/s 的网络直连带宽,这样做可以最大限度地降低瓶颈。

由于一个机架有 18个计算节点,因此总计有 9TB 的 DDR4 内存和另外 1.7TB 的 HBM2 内存,总计内存容量高达 10.7TB。一个机架的最大功率为 59kW,峰值计算能力包括 CPU 的话是 846TFlops,只计算 GPU 的话是 775TFlops。

在机架之后就是整个 Summit 系统了。完整的 Summit 系统拥有 256 个机架, 18 个交换机架, 40 个存储机架和 4 个基础架构机架。

完整的 Summit 系统拥有 2.53PB 的 DDR4 内存、475TB 的 HBM2 内存和 7.37PB 的 NVMe SSD 存储空间。

参考资料: http://www.sohu.com/a/246227428\_616364